# Vision für die Zukunft

**SICK und Microsoft** **kombinieren ihre Stärken in der 3DToF-Technologie**

**Waldkirch, 22. September 2020 – Die SICK AG (SICK) gibt bekannt, dass sie gemeinsam mit der Microsoft Corp. (Microsoft) die Entwicklung kommerzieller industrieller 3D-Kameras und verwandter Lösungen vorantreibt. Diese sind mit einem Microsoft-Ökosystem kompatibel, das auf den Plattformen Microsoft Depth, Intelligent Cloud und Intelligent Edge aufbaut. Ausgewählte Kunden testen bereits SICK-Kameras in denen die Microsoft 3DToF-Technologie integriert ist.**

Industriekameras, die auf Technologien wie aktiver und passiver Stereoskopie sowie 3D-Time-of-Flight (3DToF) basieren, gehören seit fast fünf Jahren zum Standardportfolio von SICK. Kunden aus verschiedensten Branchen nutzen die so genannten 3D-Snapshot-Kameras von SICK zur schnellen, robusten und zuverlässigen Erfassung von Abstandsbildern und den daraus ableitbaren Informationen. Das Unternehmen verfügt somit über umfangreiches technologisches Wissen sowie Markt- und Anwendungs-Know-how, um fortschrittliche 3D-Kameras zu bauen und zu entwickeln, die für den industriellen Einsatz geeignet sind.

Mit der intelligenten Tiefen-Technologie, die derzeit als Teil des Mixed-Reality-Geräts HoloLens und des Azure Kinect Development Kits angeboten wird, verfügt Microsoft über ein umfangreiches Know-how und eine große Expertise auf dem Gebiet der 3DToF-Messung.

SICK und Microsoft wollen nun gemeinsam die 3DToF-Technologien im Kontext von Industrie 4.0 weiterentwickeln und auf die 3DToF-Kameras Visionary-T von SICK anwenden, um diese mittels Azure Intelligent Cloud und Intelligent Edge smarter zu machen. Beide Unternehmen bündeln ihre Stärken und nutzen die daraus entstehenden Synergien. "Durch die ständige Verbesserung und Entwicklung neuer 3D-Kameralösungen wollen wir Technologieführer bleiben. Kooperationen mit Unternehmen wie Microsoft beschleunigen eine Implementierung und sind vor allem kostengünstiger für unsere Kunden", sagt Dr. Robert Bauer, Vorstandsvorsitzender der SICK AG.

Die 3DToF-Kamera Visionary-T Mini von SICK wird voraussichtlich Anfang 2021 für industrielle Anwendungen erhältlich sein; Prototypen sind bereits jetzt verfügbar. Die Visionary-T Mini beinhaltet eine weitere Variante der 3DToF-Technologie von Microsoft mit einer dynamischen Bandbreite und einer Auflösung von etwa 510 x 420 Pixel. Die Kamera bietet damit im Vergleich zum Azure Kinect DK eine höhere Performance, eine fortschrittliche Datenverarbeitung direkt auf der Kamera sowie folgende Erweiterungen: 24/7-Verfügbarkeit, industrielle Schnittstellen, eine verbesserte Auflösung mit schärferen Tiefenbildern und verbesserte Tiefenqualität.

**Über die 3DToF-Technologie**

3DToF ist die Messung der Laufzeit eines Lichtsignals zwischen der Kamera und der Zielszene gleichzeitig für jeden Bildpunkt. Sobald die Ankunftszeit oder die Phasenverschiebung des reflektierten Lichts bekannt ist, kann die Entfernung zum Objekt bestimmt und ein Abstandsbild erstellt werden. Die 3D-Snapshot-Technologie kann mit der Lichtlaufzeitmessung sogar unbewegte Szenen dreidimensional erfassen, ohne dass Aktoren oder mechanische Teile innerhalb der Kamera bewegt werden müssen.

Bilder:
Bildunterschrift: Funktionsprinzip der 3D-Flugzeittechnologie.

Ansprechpartner

Melanie Jendro │PR Manager │melanie.jendro@sick.de

+49 7681 202-4183 │+49 151 741 035 31

SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2019 beschäftigte SICK mehr als 10.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter [http://www.sick.com](http://www.sick.com/) oder unter Telefon +49 (0)7681202-4183